
 산업통상자원부		<h1>보도자료</h1>			
http://www.motie.go.kr					
2019년 9월 27일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 9.26.(목) 오전 11시 이후 보도 가능)					
배포일시	2019. 9. 26.(목)		담당부서	중견기업정책과	
담당과장	김홍주 과장(044-203-4360)		담당자	안드레 사무관(044-203-4361)	

소재·부품 중견기업 기술자립화, 출연연 등 공공연구기관과 함께 추진!

- 제1회 소재·부품 중견기업-공공연구기관 Tech Day 개최 -

□ 산업통상자원부(장관 성윤모)는 '19.9.26.(목) 전자부품연구원에서 '제1회 소재·부품 중견기업-공공연구기관 Tech Day(이하 테크 데이)'를 개최하였으며, 향후 분기별로 지속 개최할 예정이다.

○ 동 행사는 소재·부품 중견기업*에게 출연연·전문연구소와의 공동 기술개발 등 기술협력 기회를 제공하고자 마련된 자리로, 7개 공공 연구기관**과 중견기업연합회, 유관기관 등 200여명이 참가하였다.

* 소재·부품 중견기업은 총 602개사, 제조업 중견(1,038개, 규모기준)의 58%

** 참여기관 : 전자부품연구원, 자동차부품연구원, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국화학연구원, 재료연구소

【 행사 개요 】

- 일시 / 장소 : '19. 9. 26.(목) 14:00 / 전자부품연구원 대강당
- 참석대상 : 7개 연구기관장, KIAT.KEIT 원장, 중견기업연합회 부회장 등(약 200여명)
- 주요행사 : 기관간 협력 MoU, 연구시설 투어, 스کیل업 세미나, 1:1 상담회 등

□ 우리 중견기업은 일본 수출규제 대응과 산업 경쟁력 강화에 필수인 소재·부품을 공급하는 1·2차 벤더이자 중소기업에 대한 수요기업 역할*을 하는 핵심 기업군이다.

- 그간 중견기업은 주로 자체적인 기술개발을 통해 성장해 왔지만 글로벌 수준의 기술력을 가진 기업은 많지 않은 상황이다.

* 중견기업 R&D방식 : 자체개발 71%, 외부 공동개발 17%(중견기업 실태조사, '17)

* 보유기술이 세계 최고수준으로 응답한 비율이 3.3%(중견기업 실태조사, '17)

- 이에, 소재·부품·장비의 기술자립화 및 글로벌 최고 수준의 핵심 기술력을 단시일 내 확보할 수 있도록 우수 연구자원과 경험을 보유한 출연연, 전문연 등 공공연구기관과의 정기적인 협력 자리를 마련하게 되었다.

□ 오늘 개최한 제1회 테크 데이는 일본 수출규제 조치 대응과 연계하여 소재·부품·장비 분야를 주제로 개최하였다.

- 동 행사 계기에 7개 연구기관, 중견기업연합회, 유관기관이 중견기업의 기술경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 공동 기술개발, 출연연과 협력 네트워크 구축, 해외 연구기관·대학 등과 기술협력 등을 추진해 나가기로 하였다.

* 업무협약 기관(10개) : 전자부품연구원, 자동차부품연구원, 한국기계연구원, 한국전자통신연구원, 한국화학연구원, 한국생산기술연구원, 재료연구소, 한국산업기술진흥원, 한국산업기술평가관리원, 한국중견기업연합회

- 또한, 7개 연구기관은 중견기업이 소재·부품·장비의 핵심 기술력을 확보할 수 있도록 기관별 특성에 따라 국산화 개발, 전담지원 조직 운영 등을 추진하기로 발표하였다.

- 전자부품연구원은 차세대 반도체 및 디스플레이 등 ICT 소재·부품 국산화 개발을 지원하고, 화학연구원은 반도체 핵심 화학소재 공정 개발, 화학소재 실증 테스트베드 등을 추진하며, 한국생산기술연구원은 소재·부품·장비 생산기술 추진단을 운영하여 기업 애로 파악, 협력 R&D 발굴 등을 수행기로 하였다.

【 기관별 소재·부품 분야 주요발표 내용 】

- 전자부품연구원 : 차세대 반도체·디스플레이 등 ICT 소재·부품 국산화 개발
- 자동차부품연구원 : 수소·전기차, 자율주행차 부품 및 주요 수입 부품·장비 국산화 개발
- 한국기계연구원 : 공급기지형 R&D센터 운영, 생산공정에 필요한 전용장비 개발지원 등
- 한국생산기술연구원 : 소재·부품·장비 생산기술 추진단 운영(애로파악, 협력R&D발굴 등)
- 한국전자통신연구원 : 특화반도체, 플렉시블 전자소재, 광·RF소재 등 소재·부품 테스트 지원
- 한국화학연구원 : 반도체·디스플레이 핵심 화학소재 공정 개발, 실증 테스트베드 지원 등
- 재료연구소 : 금속·세라믹·복합소재 등 주요 소재·부품 국산화, 소재 실증단지 구축 등

○ 아울러, 사전 및 현장 접수를 통해 중견기업과 7개 연구기관별 연구원이 애로기술 해결 및 공동 기술개발, 해외 협력 네트워크 등 1:1 상담하는 시간도 가졌다.

□ 이번 행사는 중견기업과 밀접한 7개 공공연구소 합동으로 진행함으로써 기업들에게 더 많은 협력 발굴의 기회가 주어지도록 하였고

○ 가치사슬상 수요기업인 중견기업과 공동연구 등을 희망하는 중소기업들도 참여하여 중견-중소간 상호 협업의 기회도 제공될 것으로 기대된다.

□ 산업부 정승일 차관은 축사를 통해 “일본 수출규제 조치를 교훈 삼아 외부 충격에 흔들리지 않는 산업구조를 갖기 위해 산업의 허리인 중견기업인들의 역할이 중요하다”고 강조하면서,

○ “테크 데이를 계기로 연구계와 기업계가 협력하여 소재·부품·장비 자립화의 기틀을 마련하고 우수 협력모델 사례가 창출되기를 희망한다”고 밝혔다.

【붙임】 제1회 소재·부품 중견기업-공공연구기관 Tech Day 개요



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 중견기업정책과 안드레 사무관(☎ 044-203-4361)에게 연락주시기 바랍니다.

1. 행사 개요

- 목 적 : 일본 수출규제 관련 핵심 소재·부품 기술 경쟁력 제고를 위해 중견기업-공공연구기관 간 공동연구 모색의 장 마련
- 일 시 : 9.26.(목) 14:00~18:30
- 장 소 : 전자부품연구원 대강당
- 참석대상 : 중견(후보중견)기업 관계자, 7개 공공연구기관*, KIAT, KEIT, 중견기업연합회 등

* 전자부품연구원, 자동차부품연구원, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국화학연구원, 재료연구소

2. 세부 프로그램(안)

시 간	주요내용	비 고
(1부) 개회식 및 MOU		
14:00~14:10	환영사 / 축 사	전품연 원장 / 산업부 차관
14:10~14:20	공공연구기관-중견연-KIAT-KEIT MOU	공공연구기관, 중견연, KIAT
14:20~14:30	전품연 연구시설 투어 / Break Time	산업부, 중견기업 임직원 기관장 등
(2부) 스کیل업(skill-up) 세미나 및 핀포인트 매칭		
14:30~16:50	< 스کیل업(skill-up) 세미나 > 기관현황 및 핵심 보유기술, 일본 수출규제 대응방향 발표, Q&A 등	전자부품연구원
		자동차부품연구원
		한국전자통신연구원
		한국화학연구원
		한국기계연구원
		생산기술연구원
		재료연구소
16:50~18:30	< 핀포인트 매칭 > 공공연구기관-중견기업 1:1 상담	중견기업, 공공연구기관